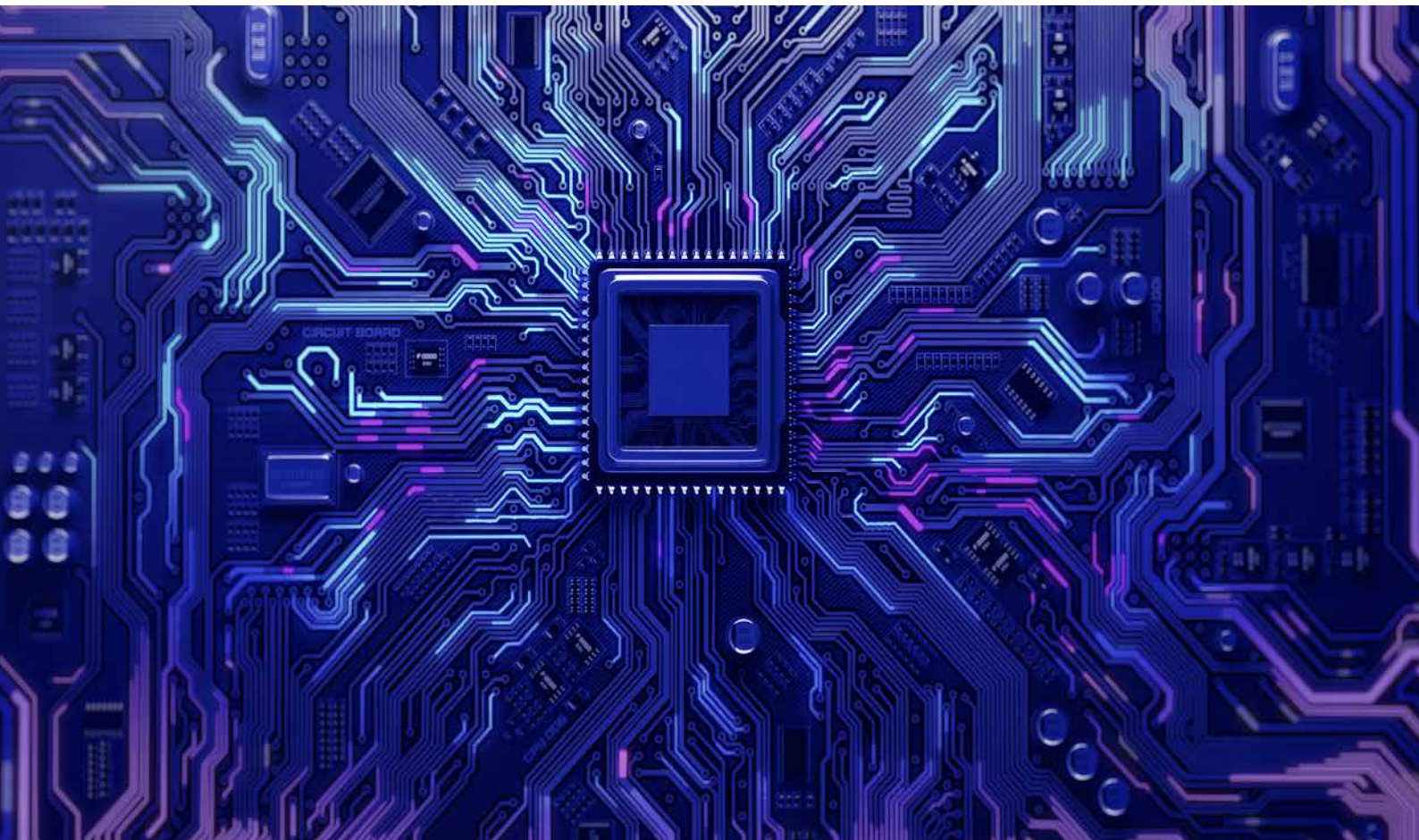
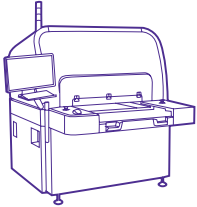


PCB製品案内



Orbotech Ultra Dimension™ 光学式自動外観検査装置 (AOI)



 Magic™ Technology

 Triple Vision™ Technology

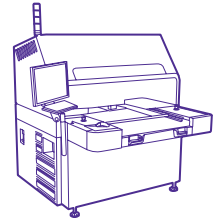
- ユニークな検査能力 - Triple Vision™ テクノロジーおよび Magic™ テクノロジー搭載
- 次世代のリモート・マルチイメージ・ベリフィケーション (RMIV Pro)
- 自動2次元計測を一体化 (2D Metrology)
- トータルコストの削減 (TCO)、Industry 4.0対応

新製品 Orbotech Ultra Dimension™ 900 – ICサブストレート製造向け、L/S 5μmまでの超微細なパターン検査と優れたレーザービア検査精度、効率性を実現

Orbotech Ultra Dimension™ LV – 最小径30μmまでのレーザービアに対して検査及び計測がシングルスキャンで可能

Orbotech Ultra Dimension™ 800/700 – L/S 10μm/15μmまでのSLP/MSAP、先端HDI、フレキシブル基板、ICサブストレートのパターンとレーザービアを1回でスキャン

Orbotech Fusion™ 光学式自動外観検査装置 (AOI)



 Multi-Image™ Technology

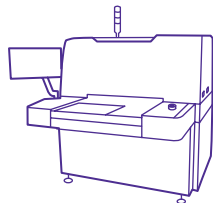
- Multi-Image™ テクノロジー による優れた検出精度
- 優れた実績を誇るSIP™ テクノロジー による検出精度
- ランニングコストの大幅な削減

Orbotech Ultra Fusion™ 300/200 – L/S 10/15μmまでのMSAP工程、先端HDI基板、フレキシブル基板、ICサブストレート向け

Orbotech Fusion™ 22 – L/S 25μmまでのフレキシブル基板と先端HDI基板向け

Orbotech Fusion™ R2R – ロールtoロールとシート検査に対応した先端フレキシブル基板向け

Orbotech Precise™ 光学式自動シェイピング装置 (AOS)

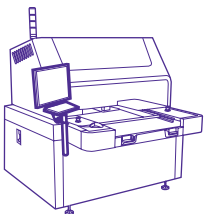


 3DS™ Technology

 CLS™ Technology

- オープンを復元し、ショートも再加工することが出来る一台二役の装置
- スクラップを削減することによる歩留まり向上
- 画期的な3D Shaping™ (3DS) テクノロジーとClosed Loop Shaping™ (CLS) テクノロジー による高品質シェイピング
- 量産工程のSLP/MSAP工程、最先端HDI基板、HDI基板、多層基板のL/S最小30μmのオープン、L/S最小25μmのショート欠陥に対応
- 内外層、マルチライン、コーナー、パッドなどすべての欠陥に対応

Orbotech PerFix™ 光学式自動シェイピング装置 (AOS)



 CLS™ Technology

- スクラップを削減 - 余分な銅箔をシェイピング加工
- Closed Loop Shaping™ (CLS) テクノロジー 搭載による優れた品質
- 高速自動シェイプを実現

新製品 Orbotech Ultra PerFix™ 500 – L/S 5μmまでの最先端ICサブストレート、ファインラインアプリケーション向け

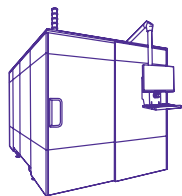
Orbotech Ultra PerFix™ 170i – L/S 7μmまでの先端ICサブストレート、ファインラインアプリケーション向け

Orbotech Ultra PerFix™ 120N – L/S 10μmまでのSLP/MSAP、ICサブストレート、フレキシブル基板向け

Orbotech PerFix™ 200S/200S XL – L/S 30μmまでの多層HDI基板と多層板向け、パネルサイズ762x927mmサイズ対応 (XL)

Orbotech PerFix™ R2R – L/S 25μmまでのフレキシブル基板向けロールtoロールおよびシートタイプオートメーションをサポート

Orbotech Infinitem™ レーザーダイレクトイメージング装置



 DDI™ Technology

 LSO™ Technology

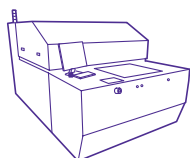
 MultiWave Laser™ Technology

- フレキシブル基板量産ライン向けの画期的なロールtoロールダイレクトイメージング装置
- KLA独自のDrum Direct Imaging™ (DDI) テクノロジーにより、最適なマテリアルハンドリング、高歩留まりでの露光を実現
- 高速連続露光とオン・ザ・フライでのターゲット認識により高スループットを実現
- 製造現場で実証されているLarge Scan Optics™ (LSO) とMultiWave Laser™ テクノロジーによりファインで均一なパターンを形成
- 一体型：高い生産性、クリーン度を持ったシステムをコンパクトサイズに設計

Orbotech Infinitem™ 10 – 最大ロール幅260mm

Orbotech Infinitem™ 10XT – 最大ロール幅 520mm

Orbotech Nuvogo™ レーザーダイレクトイメージング装置



 LSO™ Technology

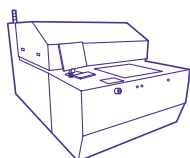
 MultiWave Laser™ Technology

- Large Scan Optics™ (LSO) テクノロジーによる優れた露光品質 – 深い焦点深度により高解像度にて歪んだ基板でも均一なパターンを形成
- MultiWave Laser™ テクノロジーによる高品質パターン形成
- 量産向け：2段テーブル搬送システムの本体にインラインオートメーションを接続し、装置稼働時間を最大限に活用
- 高い露光稼働率により、トータルコストを大幅に削減

Orbotech Nuvogo™ Fine シリーズ – 量産用、SLP/mSAP、最先端HDI、フレキシブル基板向け
高品質・高スループット露光

Orbotech Nuvogo™ シリーズ – 高エネルギー量産用、最先端HDI、HDI、フレキシブル基板、リジッドフレキシブル基板向け

Orbotech Diamond™ ソルダーマスク用DI



 SolderFast™ Technology

- ソルダーマスク向け高品質・高スループット露光
- SolderFast™ テクノロジーによる最高品質の露光を高スループットにて提供
- 深い焦点深度により、歪んだ基板でも高品質な露光が可能
- トータルコストの削減 – 長寿命LEDによりランニングコストの削減

Orbotech Diamond™ 10/10XL – 3波長露光による量産向けソルダーマスク用DI

Orbotech Diamond™ 10W – 高生産性・高品質な白色ソルダーマスク用DI

Orbotech Diamond™ 10M/10MXL – 高生産性・高品質な白色および一般ソルダーマスク用DI

Orbotech Magna™ インクジェットプリンタ



 Structural Printing™ Technology

 DotStream Pro™ Technology

- ICパッケージ、ダム、絶縁層形成用の最先端インクジェット印刷
- 高スループット、高精度、トータルコスト(TCO)の削減
- コンパクトシステム
ストリップ、パネル、JEDECトレイ、ウエハーなどに対応
- KLA独自のStructural Printing™ テクノロジー および製造現場で実証済みのDotStream Pro™ テクノロジー

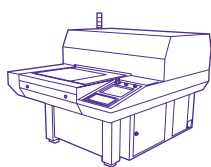
Orbotech Jetext™ インクジェットプリンタ



 DotStream Pro™ Technology

- 表面印刷にて部品周辺への熱影響やダメージなし
- 印刷密度に関係なく一貫した高いスループットとクリアな仕上がり
- コンパクトシステム
ストリップ、パネル、JEDECトレイ、ウエハーなどに対応
- 製造現場で実証済みのDotStream Pro™ テクノロジー

Orbotech Sprint™ インクジェットプリンタ



 DotStream Pro™ Technology

 MultiPrinting™ Technology

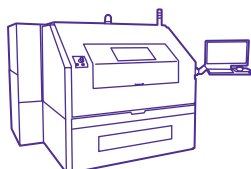
- DotStream Pro™ テクノロジー による最高のパフォーマンスとトータルコストの削減
- Multiprinting™ テクノロジー による革新的な複数パネル、マルチレベルへのシリアル印刷
- 高精細印刷と高位置精度をQTAから量産にまで対応し、かつ環境にもやさしい製造装置
- 優れたトレーサビリティ、2Dコード印刷を実現（レーザーマーキングとの置き換え）
- 実証されたトータルコストの削減（TCO）、従来の工程よりも高い歩留まりと費用削減効果

Orbotech Sprint™ 300/300 Flex – 最高速と最高品質印刷を備えた高機能装置(0.3mm 文字、75µm 線幅、2x2mm 2Dコード/グレードA)

Orbotech Sprint™ 200S/200 Flex – 複数パネル同時印刷、パーシャルスケールリング対応の高速機

Orbotech Sprint™ 150 – QTAから少、中量生産用リジットパネル向け、シングルパネル対応機

Orbotech Apeiron™ UVレーザードリル装置



 Multi-Path™ Technology

 Roll Inside™ Technology

 CBU™ Technology

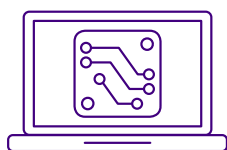
- 製造現場で実証されているMulti-Path™ テクノロジー による高速加工
- KLA独自のRoll Inside™ テクノロジー によりロール搬送部の内蔵を実現
- フレキシブル基板の2枚同時加工による高生産性
- 高品質・高位置精度加工 - 最小ビームサイズ15µm； 12µm (3σ)の画期的な加工精度
- 銅、ポリイミド、液晶ポリマー（LCP）、カバーレイヤーなどのスルーホール及びブライドピア加工対応

Orbotech Apeiron™ 800 – 最大ロール/シート幅 260mm まで対応

Orbotech Apeiron™ 800ST – 最大ロール260mm/シート幅、2 x 520mm x 260mmシート幅、1 x 520mm x 520シート幅まで対応

Orbotech Apeiron™ 800XT – 最大ロール/シート幅520mm、2 x 520mm x 260mmシート幅、1 x 520mmシート幅まで対応

CAM & エンジニアリング、Industry 4.0 ソフトウェアソリューション



新製品 Frontline Cloud Services – PCB CAMワークフローを飛躍的に向上させるCloudベースのソリューション

Frontline InFlow™ – All-in-One製造・生産設計自動化システム

Frontline InCAM®Pro – 高精細、高効率を実現したHDI及びIC/パッケージ基板向けCAMソリューション

Frontline InShop® – 製造フロアでのIndustry 4.0 ソフトウェアソリューション

Frontline InSight PCB® – セールスとエンジニア向けのすばやく、高精度なWebベースのプレCAMソリューション

KLA SUPPORT

高い歩留まりを実現するKLAのソリューションにとって、装置の生産性維持は非常に重要です。この実現のため、当社ではメンテナンス、グローバルでのサプライチェーン管理、コスト削減、老朽化の緩和、装置移設、性能・生産性の向上、認証ツールの再販売などに注力しています。

© 2022 KLA Corporation. KLAは全世界において著作権に関する権利を有します。当社は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの仕様を予告なく変更する権利を有します。「オルボテック」は、KLAカンパニーであるOrbotech Limitedの登録商標です。「KLA」とKLAのロゴは、KLA Corporationの登録商標です。記載されたブランド名および製品名は全て各社の登録商標である可能性があります。

KLA Corporation
TEL: 03-6367-2505
Email: PCB-Sales@orbotech.com
www.kla.com

Rev 7.0_4-05-2022 (J)